

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦不會成為有關邀請或要約的一部分。



**HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站就本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市刊發的《華虹半導體有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事長兼執行董事  
張素心先生

中國上海，二零二三年七月十八日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事：**

張素心（董事長）

唐均君（總裁）

**非執行董事：**

孫國棟

王靖

葉峻

**獨立非執行董事：**

張祖同

王桂壩，太平紳士

葉龍蜚

# 华虹半导体有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 招股意向书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1228号文同意注册。《华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，<http://www.cnstock.com>；中证网，<https://www.cs.com.cn>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联席主承销

商中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、国开证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	华虹半导体有限公司	证券简称	华虹公司
证券代码/网下申购代码	688347	网上申购代码	787347
网下申购简称	华虹公司	网上申购简称	华虹申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。		
定价方式	本次发行通过向符合条件的投资者询价的方式直接确定股票发行价格，不再进行累计投标询价。		
发行前总股本(万股)	130,814.7031（截至 2023 年 6 月 30 日）	拟发行数量(万股)	40,775.0000
预计新股发行数量(万股)	40,775.0000	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	171,589.7031	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	23.76%
网上初始发行数量(万股)	4,077.5000	网下初始发行数量(万股)	16,310.0000
网下每笔拟申购数量上限(万股)	3,500.0000	网下每笔拟申购数量下限(万股)	50.0000
初始战略配售数量(万股)	20,387.5000	初始战略配售占拟发行数量比(%)	50.00%
保荐人相关子公司初始跟投股数(万股)	1,631.0000	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	-
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			

初步询价日及起止时间	2023年7月20日 (9:30-15:00)	发行公告刊登日	2023年7月24日
网下申购日及起止时间	2023年7月25日 (9:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2023年7月25日 (9:30-11:30, 13:00-15:00)
网下缴款日及截止时间	2023年7月27日 16:00	网上缴款日及截止时间	2023年7月27日日终
备注：本次发行前后股份总数均以2023年6月30日已发行股份总数1,308,147,031股为基准计算。			
<b>发行人和联席主承销商</b>			
发行人	华虹半导体有限公司		
联系人	董事会办公室	联系方式	86-21-38829909
联席保荐人（联席主承销商）	国泰君安证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系方式	021-38676888
联席保荐人（联席主承销商）	海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系方式	021-23187958
联席主承销商	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系方式	010-60838692
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系方式	010-65051986
联席主承销商	东方证券承销保荐有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系方式	021-23153864
联席主承销商	国开证券股份有限公司		
联系人	资本市场组	联系方式	010-88300198

发行人：华虹半导体有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023年7月18日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）



发行人：华虹半导体有限公司

2023年7月18日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023 年



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年7月18日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2023年7月18日



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023 年 7 月 18 日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司



2023年 7 月 18 日